

# 현대차, 인도 연산 100만대 시대… 설계·R&D 현지화 속도

정의선 회장, 푸네공장 준공식 참석  
옛 GM 공장, 생산기지로 탈바꿈  
2032년까지 155억弗 대규모 투자

푸네공장 연산 32만대까지 확대 추진  
전기차 5종 출시·글로벌 수출 확대  
국내 부품사 120여곳 동반성장 기대

“지난 30년간 인도는 현대차의 글로벌 성장과정에서 핵심 축, 신공장 준공식으로 인도에서 새로운 장(章)을 열 것.”(정의선 현대자동차그룹 회장)

한때 가동이 멈췄던 인도 자동차 공장이 현대자동차의 새로운 글로벌 생산거점으로 다시 숨을 쉬기 시작했다.

공장 곳곳에서 생산 설비가 돌아가고 임직원들의 움직임이 분주해진 가운데, 현대차는 인도 시장 진출 30주년을 맞아 생산 확대와 연구개발(R&D) 현지화를 아우르는 새로운 도약을 선언했다. 정의선 현대자동차그룹 회장이 직접 준공식에 참석해 장기 투자 의지를 밝힌 것도 인도를 글로벌 성장의 핵심 축으로 키우겠다는 전략을 분명히 한 것으로 풀이된다.

현대차는 14일(현지시간) 인도 마하라슈트라주 탈레가온에서 푸네 신공장 준공식을 개최했다. 행사에는 정 회장을 비롯해 장재훈 현대차그룹 부회장, 호세



정의선 현대차그룹 회장. /현대차

무노스 현대차 대표이사 사장 등 경영진과 데벤드라 파드나비스 마하라슈트라 주 총리, 이성호 주인도대사 등 양국 주요 인사들이 참석했다. 2020년 가동을 멈춘 옛 제너럴모터스(GM) 공장이 현대차의 세 번째 인도 생산기지로 재탄생한 것이다.

정 회장은 환영사에서 인도와의 동반성장을 강조했다. 정 회장은 “30년 전 처음 인도에 진출했을 때부터 현대차는 현지 고객의 신뢰를 얻기 위해 노력했다”며 “오늘 준공식은 현대차가 인도와 함께 걸어온 여정에서 새로운 장을 여는 뜻깊은 자리이며 푸네공장 준공은 인도의 미래에 대한 현대차그룹의 강한 확신을 보여준다”고 강조했다.

이어 현대차가 인도 진출 당시 목표로

## 현대자동차 푸네 신공장 개요

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 부지 넓이 | 1.2km <sup>2</sup> (약 36만평, 축구장 166배 크기)              |
| 공장 구성 | 완성차 공장(연간 17만대), 엔진 공장(연간 15만대)<br>주행시험장, 임직원 교육시설 등  |
| 생산 능력 | 총 17만대 -1단계 확장(2028년) : 25만대<br>-2단계 확장(2030년) : 32만대 |
| 생산 차종 | 올뉴베뉴                                                  |
| 투자 금액 | 약 1조원                                                 |
| 근무 인원 | 4700여명 (그룹사·협력업체 포함 시 : 1만 2400여명)                    |



자료/현대자동차

현지 고객의 신뢰를 얻는 것이었다고 돌아보며, 소형차 쌍토로를 시작으로 인도가 글로벌 성공을 뒷받침하는 핵심 시장으로 성장했다고 평가했다. 특히 정 회장은 ‘메이크 인 인디아(Make in India)’를 넘어 ‘디자인 인 인디아(Design in India)’, ‘이노베이트 인 인디아(Innovate in India)’로 나아가겠다는 구상을 밝혔다. 단순한 현지 생산을 넘어 설계와 기술 혁신까지 인도에서 수행하겠다는 의미다.

현대차는 2032년까지 인도에 155억달러를 투자해 차세대 제조 기술과 연구개발 역량을 강화할 계획이다. 정 회장은 이를 통해 더 많은 일자리를 창출하고 협력사와 함께 인도의 산업 발전을 지원하겠다는 의지도 내비쳤다. 푸네공장은 이러

한 전략을 뒷받침할 핵심 거점이다. 현재 연간 생산능력은 17만대로, 2030년까지 32만대로 확대할 방침이다. 조립공장뿐 아니라 엔진공장과 주행시험장, 임직원 교육시설을 갖췄으며, 인공지능(AI) 기반 품질검사 시스템과 산업용 로봇 200여대를 활용해 생산 효율을 높인다. 신규 인력은 증강현실(AR) 교육을 통해 숙련도를 끌어올린 뒤 현장에 투입된다.

첫 양산 모델은 소형 스포츠유틸리티차(SUV) ‘올 뉴 베뉴’다.

인도 내수는 물론 멕시코와 칠레, 남아프리카공화국, 사우디아라비아 등 30여개국 수출을 담당한다. 푸네공장이 베뉴 생산을 맡으면 첸나이공장은 전기차(EV) 등 미래차 생산 전환에 집중할 수 있다. 푸네공장 가동으로 첸나이 1·2공장 생산

능력 82만 4000대를 포함한 현대차의 인도 생산능력은 연간 100만대 수준으로 확대됐다.

현대차는 인도 정부의 전기차 보급 확대 정책에 맞춰 현지 전동화 전략도 속도를 낸다. 현대차는 아이오닉 5와 크레타 EV에 이어 내년 1분기 인도 시장을 겨냥한 소형 전기 SUV를 출시하고, 2030년까지 신형 전기차 5종을 선보일 예정이다.

현대차의 시선은 인도 내수시장에만 머물지 않는다. 인도법인은 승용차 누적 수출 400만대를 달성했으며, 2030년 수출 비중을 30%까지 높이는 것이 목표다.

한편 현대차의 인도 푸네공장 준공이 국내 자동차 부품업체에 새로운 성장 기회로 주목받고 있다. 완성차 생산능력 확대가 부품 수요 증가로 이어지는 데다 현대차그룹이 생산시설과 연구개발(R&D), 현지 공급망에 대한 대규모 투자를 예고하면서 국내 협력사들의 인도 사업 확대에도 속도가 붙을 전망이다.

현재 현대차와 함께 인도에 진출한 국내 부품사는 120여개사에 달한다. 인도 진출 협력사인 차체부품 업체 성우하이텍은 2019년 3458억원에서 2025년 5346억원으로 54.6% 성장했으며 도어트림 공급업체 서연이화는 같은 기간 3003억원에서 5925억원으로 97% 급증했다. /푸네(인도)=양성운 기자

ysw@metroseoul.co.kr



metro



14일 서울 코엑스에서 열린 ‘SEDEX 2026’에 마련된 삼성전자 부스 전경. /삼성전자



14일 서울 코엑스에서 열린 ‘SEDEX 2026’에 마련된 SK하이닉스 부스 전경. /차현정 기자

## “HBM4·첨단 장비까지”… 삼성·SK, K-반도체 미래 펼쳤다

### Q 르포

#### ‘SEDEX 2026’ 최대 규모 개막

삼성, HBM4E·4나노 베이스다이 전시  
2나노 공정·차세대 패키징 기술 공개  
SK, HBM4E·HBF 등 신기술 선보여  
엔비디아 슈퍼칩·HBM 웨이퍼 전시

삼성전자와 SK하이닉스가 차세대 고대역폭메모리(HBM)인 HBM4E를 앞세워 인공지능(AI) 반도체 기술력을 한자리에 선보였다. 양사는 HBM4E를 중심으로 차세대 메모리와 첨단 패키징 기술 등을 공개하며 AI 반도체 시장의 기술 경쟁을 예고했다.

14일 서울 강남구 코엑스에서는 국내 최대 반도체 전문 전시회인 ‘반도체대전(SEDEX) 2026’이 개막했다. 한국반도체산업협회가 주최하는 이번 행사에는 300개 기업이 888개 부스 규모로 참가했으며 오는 16일까지 열린다. 현장에는 반도체 업계 관계자를 비롯해 대학생과 일반 관

람객들의 발길이 이어졌다.

삼성전자 전시관에서는 HBM4E 구조 모형을 살펴보거나 전시 제품에 대한 설명을 듣는 관람객들의 모습이 눈에 띄었다.

부스 한편에서는 반도체 관련 퀴즈를 맞히는 참여형 행사도 진행됐다. 삼성전자는 ‘Architecting AI Systems’를 주제로 메모리부터 파운드리, 첨단 패키징까지 아우르는 기술을 소개했다.

전시의 중심에는 7세대 HBM인 HBM4E가 자리했다. 삼성전자는 HBM4E 구조 모형을 통해 고성능 메모리 기술을 소개하는 한편 4나노 공정을 적용한 HBM4E 베이스다이도 전시했다. 메모리와 로직 반도체, 첨단 패키징을 아우르는 통합 역량을 강조한 것이다.

차세대 메모리 기술도 선보였다. 그래픽처리장치(GPU)와 메모리 사이의 물리적 거리를 줄이는 3차원(3D) 메모리 구조인 ‘zHBM’과 옛 AI용 낸드 솔루션 ‘z NAND-O’의 모형을 공개했다. 메모리

내부에 연산 기능을 통합한 ‘LPDDR-PI M’도 소개했다.

파운드리 분야에서는 2나노 게이트올 어라운드(GAA) 공정 웨이퍼와 첨단 패키징 기술인 ‘2.3D Cube-E’, ‘3D Cube-H’ 등을 전시했다.

올해 신설한 반도체 클러스터존에서는 약 360조원을 투자할 예정인 용인 국가산업단지 조성 계획도 소개했다.

SK하이닉스 전시관에서도 관람객들이 HBM을 비롯한 차세대 메모리 제품을 살펴봤다. 육상 트랙을 형성화한 부스를 따라 HBM 개발 역사와 주요 제품을 소개하는 전시물이 이어졌다. SK하이닉스는 ‘멈추지 않고 나아가는 AI 여정’을 주제로 AI 인프라부터 PC·모바일까지 다양한 메모리 솔루션을 선보였다.

SK하이닉스 역시 HBM4E를 핵심 제품으로 내세웠다. 전시관에는 HBM·고대역폭클래시(HBF) 구조 모형과 함께 엔비디아의 차세대 AI 반도체인 ‘베라 루빈’ 슈퍼칩, 젠스 황 엔비디아 최고경영자(C

EO)의 친필 사인이 담긴 HBM 웨이퍼가 전시됐다. 이를 통해 HBM 기술력과 엔비디아와의 협력 관계를 강조했다.

HBM을 보완할 차세대 기술로는 HBF를 소개했다. HBF는 낸드플래시에 HBM의 적응 및 고속 입출력 기술을 적용한 메모리로, 동세대 HBM 대비 절반 수준의 대역폭과 약 10배의 용량을 구현하는 것이 개발 목표다.

AI 추론 과정에서 늘어나는 대용량 데이터 처리 수요에 대응하기 위한 기술이다.

이 밖에도 SK하이닉스는 서버용 메모리인 ‘256GB 3DS RDIMM’, ‘128GB MRDIMM’과 액체냉각을 지원하는 기업용 솔리드스테이트 드라이브(eSSD), PC·모바일용 D램 등을 전시했다.

HBM뿐 아니라 다양한 메모리와 저장장치를 통해 AI 시스템 전반의 수요에 대응한다는 구상이다.



/차현정 기자 hyeon@

metro

## 안현 SK하이닉스 사장

## 차세대 HBF 개발 속도 AI메모리 병목 해소 추진

“AI 인프라의 지속적인 성장을 위해서는 개별 메모리의 성능 향상을 넘어 전체 메모리 계층을 최적화해야 한다.”

안현 SK하이닉스 개발총괄 사장(CDO)은 14일 서울 강남구 코엑스에서 열린 ‘반도체대전(SEDEX) 2026’ 기조연설에서 이같이 말했다. 인공지능(AI) 추론 시장이 급성장하면서 메모리 계층 간 데이터 이동이 새로운 병목으로 떠오른 만큼 고대역폭메모리(HBM)를 넘어 차세대 메모리 기술을 확보해야 한다는 분석이다.

SEDEX 기조연설서 전략 제시  
AI메모리 계층 최적화 필요성 강조  
HBF 용량 HBM 대비 10배 확대

안 사장은 이날 ‘AI 시대, 메모리 기술의 진화방향’을 주제로 차세대 메모리 기술 로드맵을 제시했다. AI가 이전 연산 정보를 저장하고 재활용하는 ‘KV 캐시’의 용량이 급증하면서 HBM과 D램, 솔리드스테이트 드라이브(SSD) 간 데이터 이동에 따른 처리 지연과 전력 소모가 새로운 병목으로 부상하고 있다는 설명이다. 안 사장은 AI 인프라의 성능 규모가 2030년에는 올해 대비 약 20배까지 확대될 것으로 전망했다. 대표적인 차세대 기술로는 고대역폭클래시(HBF)를 제시했다.

안 사장은 “HBF는 기존 HBM보다 대역폭은 절반 수준이지만 용량은 10배 이상으로 늘릴 수 있다”고 설명했다.



/차현정 기자

metro